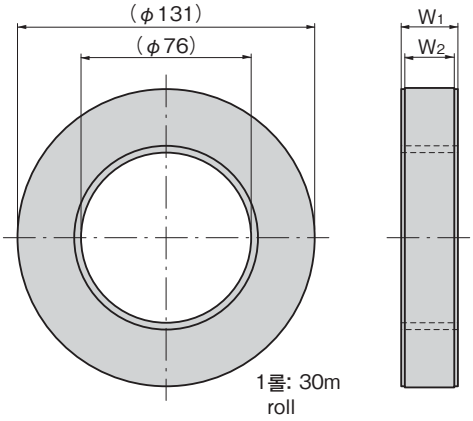
C-300-MCU-T·C-300-MCU-M
구리제

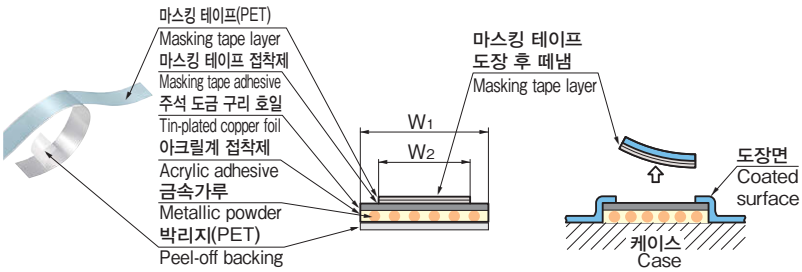
도전성 마스킹 테이프
SHIELDING TAPE (masking)



C-300-MCU-T25

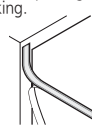
구조 Construction

마스킹 테이프는 제품에 부착되어 있어 간단히 떼어낼 수 있습니다.
Masking tape is adhered to the product, and can be peeled away easily.

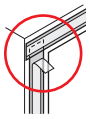


사용 방법 Application method

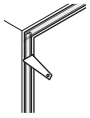
1. 접착면의 먼지와 유분을 떨어뜨리고 박리지를 떼어내면서 C-300-MCU-T를 붙입니다.
1. Remove any grime and oil from contact surface, then adhere C-300-MCU-T while peeling the backing.



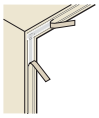
2. 코너는 먼저 붙인 C-300-MCU-T와 마스킹 테이프 사이에 끼웁니다.
2. Place corner between C-300-MCU-T adhered first and masking tape.



3. 주걱 등으로 확실하게 눌러 도장합니다.
3. Press firmly with a putty knife, etc. and coat.



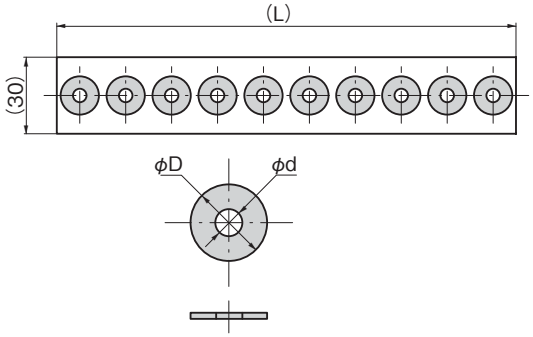
4. 도장 후 마스킹 테이프를 떼어냅니다.
4. After coating, remove masking tape.



상품번호 Product No.	RoHS 10	W1	W2	코드 Code
C-300-MCU-T10	●	10	6.8	24341
C-300-MCU-T13	●	13	9.8	24342
C-300-MCU-T19	●	19	15.8	24343
C-300-MCU-T25	●	25	21.8	24344

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

C-300-MCU-M4
와셔 타입
Washer format



특징 Feature

- 마스킹 테이프가 부착된 주석 도금 구리 호일입니다.
- 케이스에 대한 도전 처리(도금·도전 도장)를 생략할 수 있습니다.
- 도장 후 마스킹 테이프는 쉽게 주석 도금 구리 호일 표면에서 떼어 낼 수 있습니다.
- 마스킹 테이프 박리 후의 주석 도금 구리 호일 표면은 도전면으로 사용할 수 있습니다.
- 도전성 접착제를 사용하고 있기 때문에 차폐 효과를 저하시키지 않습니다.
- 가공·부착 작업을 쉽게 할 수 있습니다.

- Tin-plated copper foil with masking tape.
- Saves you the trouble of applying conductivity treatments (plating or conductive coating) to a casing or housing.
- Following application, simply peel the masking tape away from the tin-plated copper foil surface.
- After masking tape removal, the tin-plated copper foil can be used as a conducting surface.
- Uses electrically conductive adhesive to minimize any shielding effect.
- Easy handling and application.

사양	● 1롤 30m
용도	● 케이스의 접지와 차폐 ● 도장 시의 마스킹과 케이스의 방식
비고	● 절단 가공품, 이형 가공품 제작도 가능합니다.

Specifications	● One roll: 30m
Specific-use	● Grounding/shielding for cases/housings ● Masks during painting and prevents casing corrosion.
Remarks	● Can also be made as a cut product and in irregular shapes.

특성 Characteristics

항목 Item		수치 Value
마스킹 테이프 두께(μm) Masking tape thickness		100
마스킹 테이프 접착제 두께(μm) Peel-off glue thickness		20
주석 도금 동박 두께(μm) Tin-plated copper foil thickness		52
아크릴계 접착층 두께(μm) Acrylic adhesive layer thickness		40
제품 두께(μm) Product thickness		212
마스킹 테이프 접착력 180° 주석 도금 동박에서 떼어내기(N/25mm) Adhesive strength	초기값 Initial value	0.4
	180℃・20분 가열 후 After 180℃ heating for 20minutes	(1.1)
아크릴계 접착제 접착력 180° SUS에서 떼어내기(N/25mm) Adhesive strength	초기값 Initial value	15.5 이상
	180℃・20분 가열 후 After 180℃ heating for 20minutes	25.8 이상
접촉저항값(Ω/13mm²/19.6N) Contact resistance	초기값 Initial value	0.001 이하
	180℃・20분 가열 후 After 180℃ heating for 20minutes	0.005 이하
사용 온도 범위(℃) Usable temperature range		-40 ~ +80

특징 Feature

- 특성은 C-300-MCU-T와 같습니다.
- Characteristics are the same as for C-300-MCU-T.

사양	● 1시트 10매입
Specifications	● One sheet: 10pcs

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	φd	φD	(L)	코드 Code
C-300-MCU-M4	●	M4용 For M4	4.3	15	180	24345
C-300-MCU-M5	●	M5용 For M5	5.3	15	180	24346
C-300-MCU-M6	●	M6용 For M6	6.3	17	200	24486
C-300-MCU-M8	●	M8용 For M8	8.3	19	200	24487

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.